



第4回研究会

3DHIアライアンス第4回研究会

12:45 開場

13:00 ~ 13:45 「人と技術をつなぎ、未来をひらく」

株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ
シニアテクノロジーエグゼクティブ 三河 巧 氏

13:45 ~ 14:30 「現場エンジニアによるデータ解析・機械学習・人工知能に基づくプロセスの設計および管理」

明治大学 理工学部 応用化学科 准教授 金子 弘昌 氏

14:30 ~ 15:15 「3D集積を可能にするディスクのKKM技術」

株式会社ディスク 営業技術部 寺西 俊輔 氏

15:15 ~ 15:30 休憩

15:30 ~ 16:15 「3DHI Solution 技術の対応状況とコア技術課題」

東京エレクトロン九州株式会社
プロセス技術部3DHI/新事業プロセス 担当部長 近藤 良弘 氏

16:15 ~ 17:00 「3DHIの具体的な活動について」

- 横浜国大・LSTC及び新規開設半導体研究センターでのR&Dに関するアナウンス
3DHI代表 井上 史大 氏
- 大阪公立大学内研究所での研究・教育事業の最新状況のご紹介
3DHI理事長 齊藤 丈靖 氏
- 事務局からのご報告およびご連絡
3DHI事務局長 島内 秀 氏

17:00 ~ 17:30 「名刺交換会（会場のみ）」